

檔案：
保存年限：

中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 1246 室
承辦人及電話：吳素敏資深經理 03-5913477

受文者：國立清華大學 學務處

速別：最速件
密等及解密條件：無
發文日期：中華民國一〇四年十月十五日
發文字號：（一〇四）導協字第 64 號
附件：如文

主旨：檢送本會「2016 TSIA 博士研究生半導體獎」與「2016 TSIA 新進研究人員半導體獎」申請辦法與申請表等相關附件，請惠予公布並推薦優秀博士研究生與博士後研究員參選。

說明：

- 一、本會為獎勵國內博士研究生及新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作活動並有具體貢獻，特舉辦「2016 TSIA 博士研究生半導體獎」與「2016 TSIA 新進研究人員半導體獎」選拔活動。
- 二、檢附相關申請辦法、申請表、推薦函等文件，惠請公布並推薦貴校優秀之博士研究生與博士後研究員參選。
- 三、受理申請日期為 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日止。請於上述截止日前，依申請辦法相關規定將推薦資料以掛號郵寄至或親送予本會遴選委員會總幹事，聯絡資訊請見申請辦法第 13 項規定。
- 四、得獎名單將於 2016 年 3 月公布於本會官網 www.tsia.org.tw 並通知 貴校。

正本：國立臺灣大學學務處、國立清華大學學務處、國立交通大學研究發展處、國立成功大學學務處、國立中央大學學務處、國立中正大學學務處、國立中興大學學務處、國立中山大學學務處、國立臺北科技大學學務處、國立臺灣科技大學學務處

副本：各校電資學院、電機學院、理學院、工學院等
TSIA 產學委員會委員

中華民國台灣半導體產業協會

2016 TSIA 博士研究生半導體獎申請辦法

民國一〇三年十一月二十六日修訂通過

民國一〇四年九月十七日修訂通過

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士研究生積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 博士研究生半導體獎」十名，每名頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

3-1 105 年度起從國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大與台科大共十所大學之博士研究生中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 已通過博士資格考之博士班研究生。

3-3 經指導教授推薦者。

四、申請時間：

本會於 2015 年 10 月上旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於 2016 年 3 月之本會年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

8-1 各校依第三項規定向本會推薦最多 10 名博士研究生。TSIA 遴選委員會針對各校推薦名單進行兩次評選：初選於各校名單中各選出 3 名為候選人；複選於各校候選人中各出 1 名傑出博士研究生，共計 10 名，即為得獎人。若複選仍無法選出得獎人，則增口試會議定之。

8-2 若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 學生證及身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。

9-4 博士班修習期間成績單正本。

9-5 參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 檔案光碟一份，請將上述文件掃描為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

林永隆 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授

電話：(O) 03-573-1072

地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號

國立清華大學 資訊工程學系

Email Address: ylin@cs.nthu.edu.tw

附件一、「2016 TSIA 博士研究生半導體獎」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址			
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、參與學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟：
(若欄位不足，請自行新增。)

事蹟名稱	主辦單位	時間(西元年/月/日)	概述

八、學生證正反面影本

<p>學生證正面黏貼處</p>	<p>學生證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

九、身份證正反面影本

<p>身份證正面黏貼處</p>	<p>身份證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

十、應備文件點檢表：

項目	請打"v"	文件名稱
10-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
10-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
10-3		學生證及身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
10-4		博士班修習期間成績單正本。
10-5		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
10-6		檔案光碟一份，請將 10-1~10-5 文件掃描為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

附件二、「2016 TSIA 博士研究生半導體獎」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

推薦人簽名:

日期： 年 月 日

2016 TSIA 新進研究人員半導體獎申請辦法

民國一〇三年十一月二十六日修訂通過

民國一〇四年九月十七日修訂通過

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 新進研究人員半導體獎」一至二名，頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

下列大學新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)取得博士學位後從事研究工作，以申請截止日為基準，滿 2 年未達 5 年者。2016 年度起從國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大與台科大共十所大學之傑出新進研究人員中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

四、申請時間：

本會於 2015 年 10 月中旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於 2016 年 3 月之本會年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

各校可推薦最多 3 名研究員。若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。

9-4 工作服務證明正本。

9-5 取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 檔案光碟一份，請將上述文件掃描為單一 PDF 檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

林永隆 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授

電話：(O) 03-573-1072

地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號

國立清華大學 資訊工程學系

Email Address: ylin@cs.nthu.edu.tw

附件一、「2016 TSIA 新進研究人員半導體獎」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址			
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、參與學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟：
(若欄位不足，請自行新增。)

事蹟名稱	主辦單位	時間(西元年/月/日)	概述

八、身份證正反面影本

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: auto; padding: 5px;"> <p>身份證正面黏貼處</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: auto; padding: 5px;"> <p>身份證反面黏貼處</p> </div>
---	---

3

九、應備文件點檢表：

項目	請打"v"	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		工作服務證明正本。
9-5		取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		檔案光碟一份，請將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

附件二、「2016 TSIA 新進研究人員半導體獎」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

推薦人簽名：

日期： 年 月 日